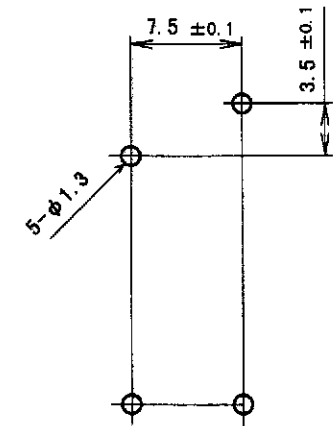
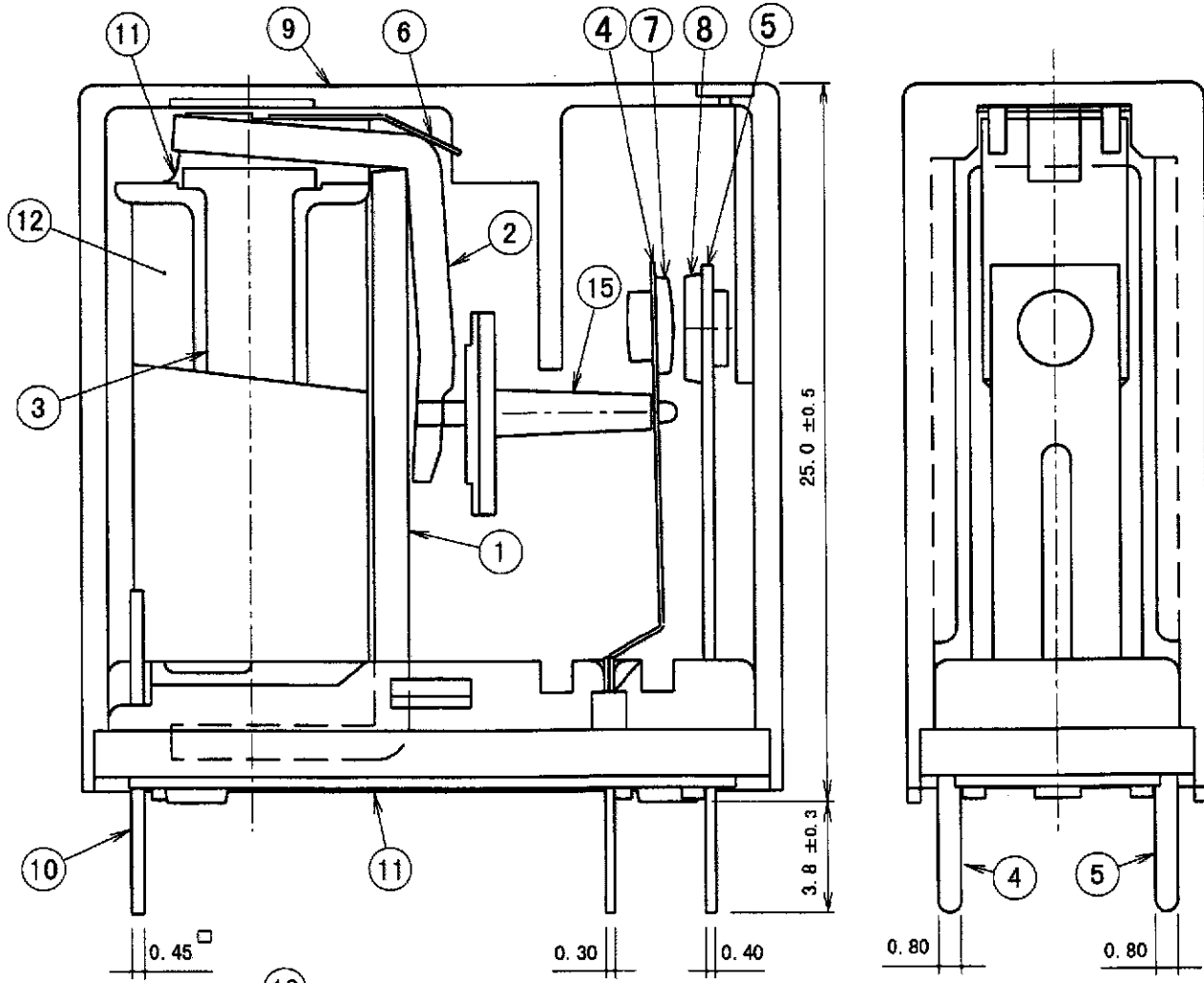
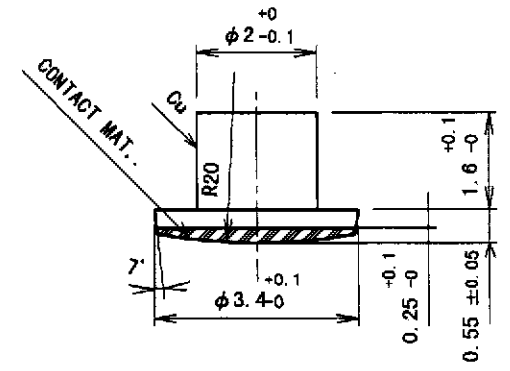


△ 1 . . .  
 △ 2 . . .  
 △ 3 . . .

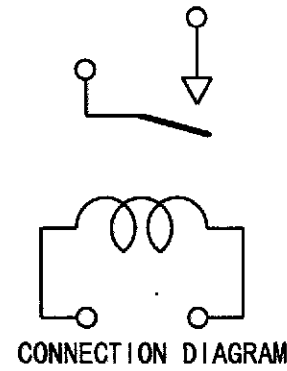
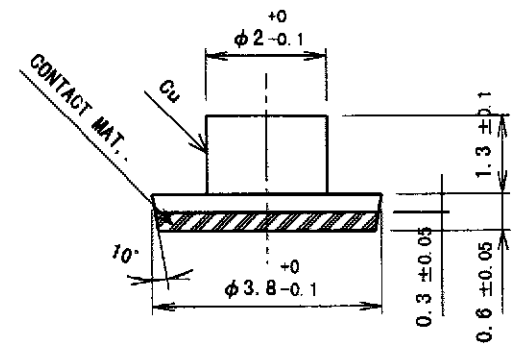


DRILLING DIAGRAM (2/1)

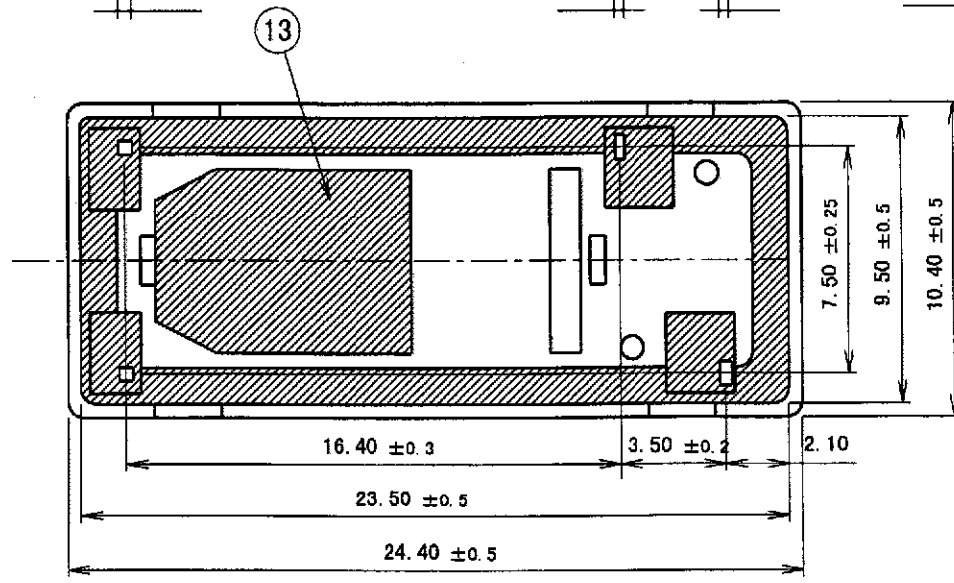
#7 DETAIL (8/1) FOR SPST CONTACT



#8 DETAIL (8/1)



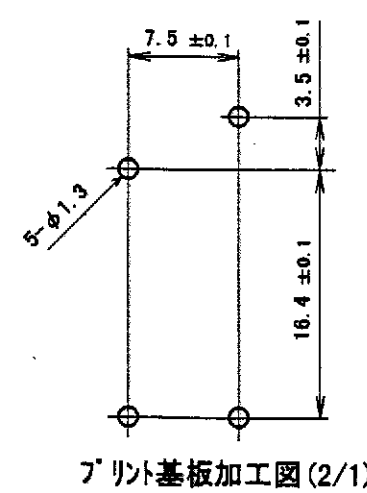
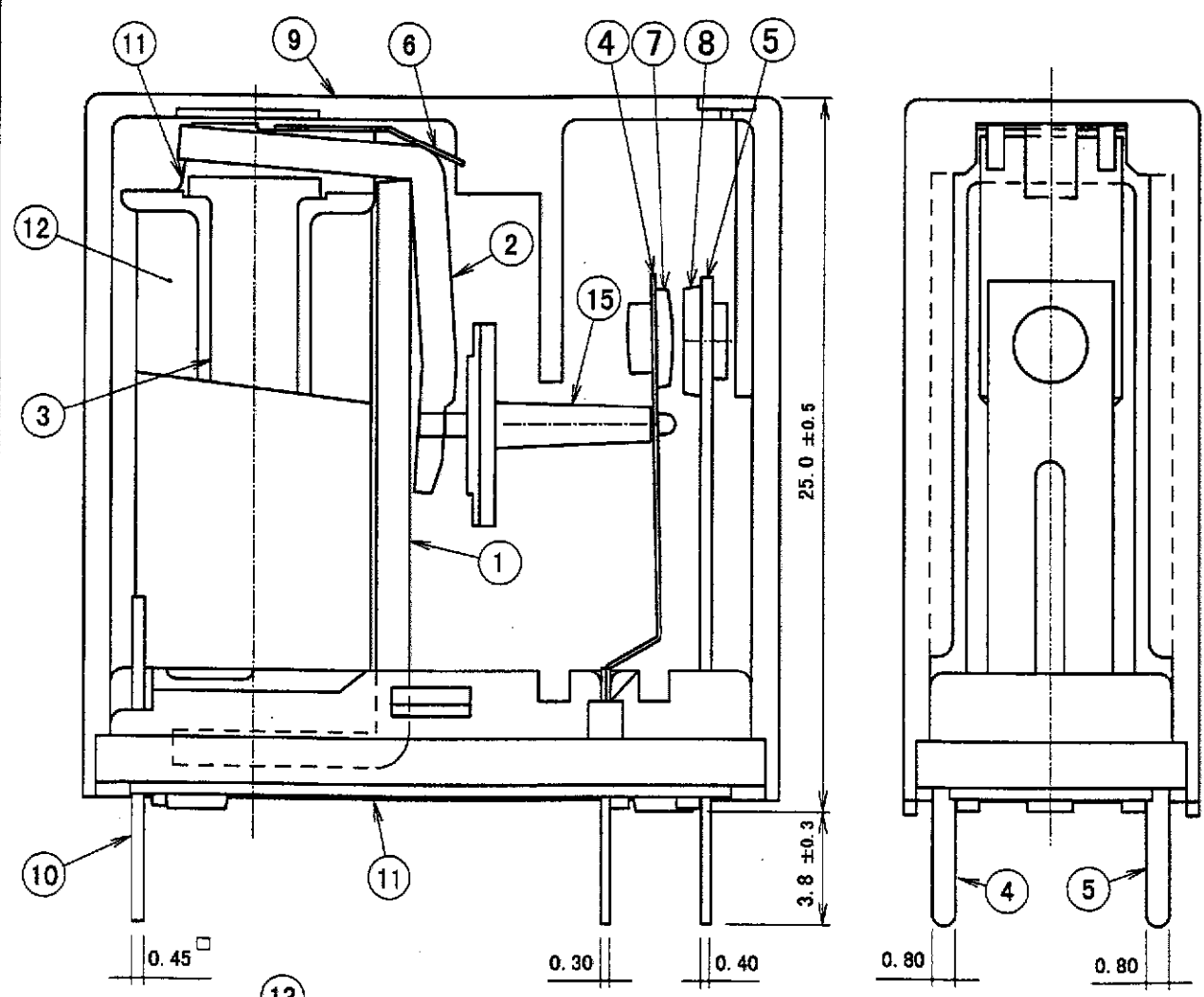
CONNECTION DIAGRAM



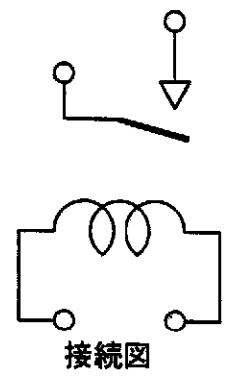
15	CARD	P. P. S		94V-0	R-10 5002C PHILLIPS
14					
13	RESIN	EPOXY			
12	MAGNET WIRE	U, E, W			E CLASS
11	BOBBIN	P, B, T		94V-0	5010GN6-15 MITSUBISHI
10	COIL TERMINAL	C, P WIRE	SOLDER DIP		0.45x0.45
9	CASE	P, B, T		94V-0	5010N6 MITSUBISHI
8	S-CONTACT	SILVER ALLOY			φ3.8x0.6
7	C-CONTACT	SILVER ALLOY			φ3.4x0.55
6	HINGE SPRING	PBP			0.15t
5	M-TERMINAL	Cu-Fe ALLOY	SOLDER DIP		0.4t
4	C-TERMINAL	Cu-Ni ALLOY	SOLDER DIP		0.15t
3	CORE	S-10R	ANNEAL FNM2		φ3.0
2	ARMATURE BRACKET	SPCC	ANNEAL FNM2		1.2t
1	FRAME BRACKET	SPCC	ANNEAL FNM2		1.2t
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	UL-94	NOTES

DRAWN	M. INNAMI	TYPE:	SDT-SS/SH-10DDM	ISSUE: 1992. 12. 08
CHECK		4/1		DRAWING NO. :
APPROVE	K. LARX			U-1421-00

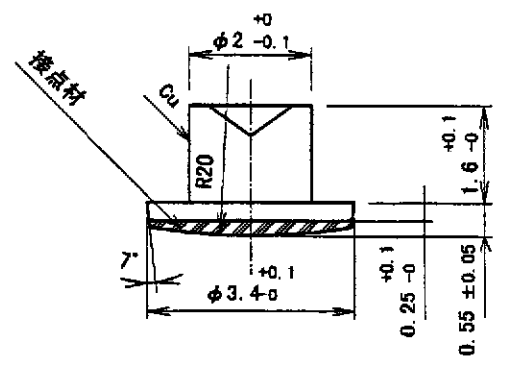
△1 . . .  
△2 . . .  
△3 . . .



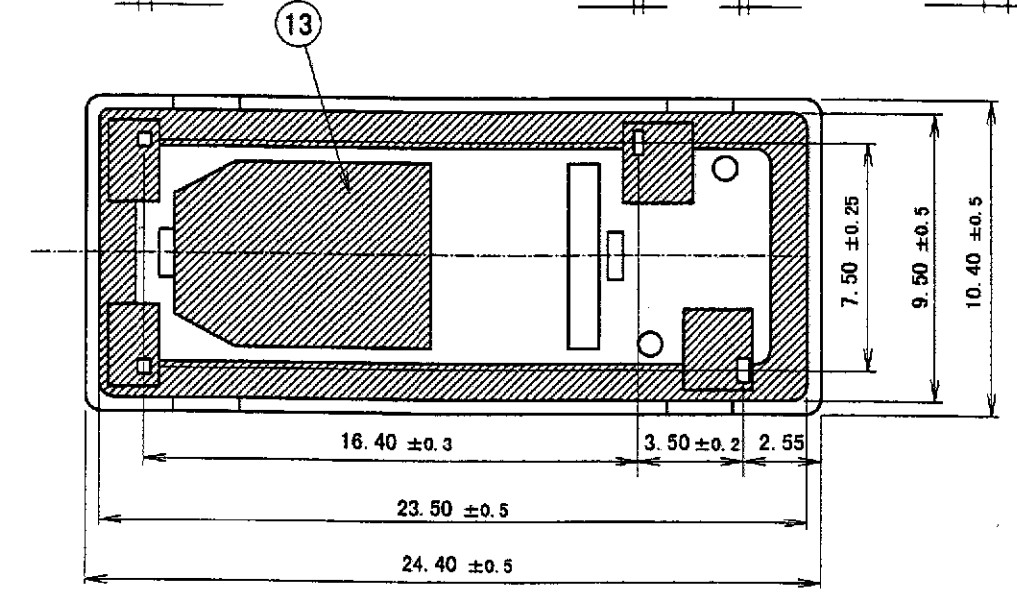
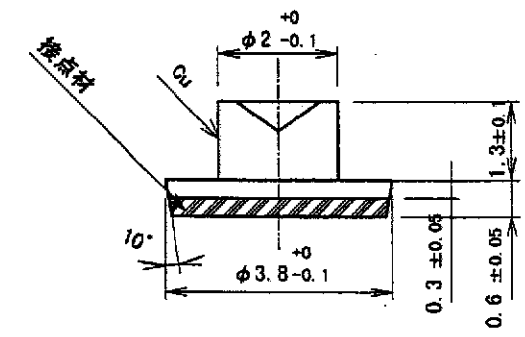
プリント基板加工図 (2/1)



#7 可動接点詳細図 (8/1)



#8 固定接点詳細図 (8/1)



15	カード	P. P. S		94V-0	フリップス R-10 5002C
14					
13	シール剤	エポキシ			
12	線材	U. E. W			E種
11	ボビン	P. B. T		94V-0	三菱 5010GN6-15
10	コイル端子	C. P線	予備半田		0.45 × 0.45
9	ケース	P. B. T		94V-0	三菱 5010N6
8	固定接点	AgSn0In0			φ3.8 × 0.6
7	可動接点	AgSn0In0			φ3.4 × 0.55
6	ヒンヂスプリング	PBS			t 0.15
5	A-端子	高導電率合金	予備半田		t 0.4
4	C-端子	Cu-Ni合金	予備半田		t 0.15
3	鉄芯	S-10R	アニール 銅下Niメッキ		φ3.0
2	アマチュア	SPCC	アニール 銅下Niメッキ		t 1.2
1	ヨーク	SPCC	アニール 銅下Niメッキ		t 1.2
分号	名 称	材 質	処 理	自 消 性	そ の 他

設 計	印 南	検 図	承 認	尺 度	4 / 1	品 名	SDT-SS/SH-100DM	発行	1992年2月1日
								図番	U-1328